



アルカリ現像型PKG用SR AZ1 Series

(大型IC、高信頼性パッケージ対応)

Photo-imageable Solder Resist for Large Scale and High Reliability

特長 Features

- 高クラック耐性
Excellent Anti Crack Resistance at TST/TCT
- 高BHAST特性
Excellent BHAST Performance
- 大型、多ピンICに最適
Suitable for Large Die & High I/O Count
- 液状、フィルムタイプの両方をラインナップ
We can provide both Liquid type and Dry Film type

特性 Properties

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| ガラス転移点 Tg *TMA method | 150-160 °C |
| 線膨張係数 CTE ($\alpha 1$) | 35-40 ppm |
| 弾 性 率 Young's modulus | 3.5-4.0 GPa |
| 破 壊 強 度 Tensile strength | 90-95 MPa |
| 破壊伸び率 Elongation | 6.0-7.0 % |
| HAST 耐性 (130°C/85%RH, 5V,L/S=12/13) | 300 h Pass |
| 冷熱サイクル耐性 (150°C \leftrightarrow -65°C) | 1000 cycles Pass |

